

# KMD 560 – CuSn6 – C51900 – CW 452 K



## 应用范围

接触弹片，连接器，簧片，开关件，固定触点。超高强度弹性元件。

## 物理性能

密度	克/厘米 <sup>3</sup>	8,8
导热性	瓦/(米·开)	75
导电性	毫西门子/米	8
导电性	IACS (%)	13
热膨胀系数	10 <sup>-6</sup> K	18,5
弹性模量	千兆帕	118

## 化学成分(%)

铜	余量
锡	5,5 – 7,0
磷	0,01 – 0,4

状态	强度等级	抗拉强度 抗拉强度 最小值-最大值 兆帕	屈服强度 Rp 0,2 最小值 兆帕		延伸率 延伸率 最小值 %		硬度 (参考值) 维氏硬度	导电性 毫西门子/米	弯曲性能 90° <sup>1) 2) 3)</sup> 铜带厚度 ≤0,5 毫米			
			3)	4)	3)	4)			R/t 好方向		R/t 坏方向	
									张力校直	热应力消除	张力校直	热应力消除
冷加工硬化	R350	350 – 420	max. 300		45		80 – 120	8	0	0	0	0
冷加工硬化	R420	420 – 520	350	340	22	29	120 – 170	8	0	0	0	0
冷加工硬化	R500	500 – 590	450	410	15	22	160 – 190	8	0	0	0	0
冷加工硬化	R560	560 – 650	520	490	10	15	180 – 210	8	0	0	0	0
冷加工硬化	R640	640 – 730	590	570	5	12	200 – 230	8	0	0	1	0,5
冷加工硬化	R720	min. 720	650	620	–	4	min. 210	8	–	1	–	–
冷加工硬化	R850 <sup>5)</sup>	min. 850	–	800	–	1,5	min. 240	8	–	1	–	–

5) 厚度范围: 0,15-0,60 mm

on request in fine grain size version

\* 室温下的参考值

\*\* 温度范围 20 – 300 °C

\*\*\* 最低强化状态下的数值

<sup>3)</sup> 张力校直

<sup>1)</sup>  $r = x \cdot t$  (适用于铜带厚度  $t < 1$ ) <sup>2)</sup> 样品宽度=10mm/可以根据要求在更窄的宽度进行弯曲测试 (评估方法依据手册页5.4.2)

<sup>4)</sup> 热应力消除

免责声明: 由于生产工艺可能的变更及差异, 本手册及数据表上的公布的信息不能保证。本公司保留变更, 修订上述内容的权利。因所提供的信息造成的任何问题, 本公司不承担任何责任。

版次: 03/2016

KMD集团上海分公司

新华路664号万宝国际商务中心433室  
上海市  
中国

电子邮件:

电话: +86 21 64478680

传真: +86 21 62256851

<http://www.kmdgroup.com/>